

2025-2030年中国半导体硅片行业“专精特新”发展研究及投资战略规划报告

目 录

CONTENTS

第1章：中国半导体硅片行业“专精特新”发展概述

1.1 半导体硅片行业的界定

- 1.1.1 半导体硅片概念界定
- 1.1.2 半导体硅片所处产业链环节
- 1.1.3 半导体硅片产品分类
- 1.1.4 半导体硅片所属国民经济行业分类

1.2 “专精特新”概念界定

- 1.2.1 “专精特新”概念解读
- 1.2.2 “专精特新”相关概念辨析
 - (1) 专精特新“小巨人”
 - (2) 专精特新中小企业
 - (3) 其他相关概念辨析

1.3 “专精特新”发展背景及发展地位分析

- 1.3.1 “专精特新”发展背景-内因分析
 - (1) 中国中小企业发展现状
 - (2) 中国制造业发展现状
 - (3) 服务“国内国际双循环”发展格局
- 1.3.2 “专精特新”发展背景-外因分析
 - (1) 全球贸易摩擦加剧、外部环境动荡
 - (2) 中国高科技发展遭遇“卡脖子”
- 1.3.3 “专精特新”发展地位分析

1.4 本报告研究范围界定说明

1.5 本报告数据来源及统计标准说明

第2章：全球及中国半导体硅片行业发展现状分析

2.1 全球半导体硅片行业发展现状

- 2.1.1 全球半导体硅片行业发展规模
- 2.1.2 全球半导体硅片行业区域发展格局
- 2.1.3 全球半导体硅片行业企业竞争格局

2.2 中国半导体硅片行业发展现状

- 2.2.1 中国半导体硅片行业发展规模
- 2.2.2 中国半导体硅片行业区域发展格局
- 2.2.3 中国半导体硅片行业企业竞争格局

2.3 中国半导体硅片行业技术水平及国产化现状

- 2.3.1 中国半导体硅片行业技术发展现状
 - (1) 半导体硅片行业技术创新现状
 - (2) 半导体硅片行业专利申请情况
 - (3) 半导体硅片行业技术研发趋势
- 2.3.2 中国半导体硅片行业国产化发展现状
 - (1) 半导体硅片行业国产化率分析
 - (2) 半导体硅片行业本土企业布局

2.4 中国半导体硅片行业发展机遇与挑战分析

第3章：中国半导体硅片行业“专精特新”政策环境及投融资环境分析

3.1 中国半导体硅片行业“专精特新”政策环境分析

- 3.1.1 国家层面半导体硅片行业发展相关政策及规划汇总解读
 - (1) 半导体硅片行业发展相关政策汇总
 - (2) 半导体硅片行业发展相关规划汇总
- 3.1.2 国家层面半导体硅片行业“专精特新”相关政策汇总解读
- 3.1.3 国家“十四五”规划对半导体硅片行业发展的影响分析
- 3.1.4 “国内国际双循环”战略的提出对半导体硅片行业的影响分析

- 3.1.5 半导体硅片行业“专精特新”发展的政策机遇分析
- 3.2 中国半导体硅片行业“专精特新”投融资环境分析
 - 3.2.1 中国半导体硅片行业“专精特新”领域主要资金来源
 - 3.2.2 中国半导体硅片行业“专精特新”领域投融资主体
 - 3.2.3 中国半导体硅片行业“专精特新”领域投融资方式
 - 3.2.4 中国半导体硅片行业“专精特新”领域投融资事件汇总
 - 3.2.5 中国半导体硅片行业“专精特新”领域投融资机遇分析
 - (1) 半导体硅片行业“专精特新”财税扶持力度
 - (2) 半导体硅片行业“专精特新”信贷支持政策
 - (3) 半导体硅片行业“专精特新”市场化融资渠道
 - (4) 北京交易所成立带来的发展机遇分析
- 3.3 中国半导体硅片行业“专精特新”发展战略支撑及保障
- 第4章：中国半导体硅片行业“专精特新”企业培育方案及培育现状解读
 - 4.1 中国半导体硅片行业“专精特新”企业培育方案解读
 - 4.1.1 半导体硅片行业国家级“专精特新”企业培育目的
 - 4.1.2 半导体硅片行业国家级“专精特新”企业培育对象
 - 4.1.3 半导体硅片行业国家级“专精特新”企业培育内容
 - 4.1.4 半导体硅片行业国家级“专精特新”企业培育措施
 - 4.1.5 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业奖励标准
 - 4.2 中国半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业申报条件及流程解读
 - 4.2.1 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业申报-基本条件
 - 4.2.2 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业申报-专项条件
 - 4.2.3 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业申报-分类条件
 - 4.2.4 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业申报流程解读
 - 4.3 中国半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业培育现状分析
 - 4.3.1 全国专精特新“小巨人”企业培育现状
 - (1) 专精特新“小巨人”企业培育进展
 - (2) 专精特新“小巨人”企业培育特征
 - (3) 专精特新“小巨人”企业行业分布
 - 4.3.2 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业培育现状
 - (1) 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业培育进展
 - (2) 半导体硅片行业专精特新“小巨人”企业培育特征
- 第5章：中国半导体硅片产业链全景梳理及“专精特新”重点领域汇总
 - 5.1 中国半导体硅片产业结构属性（产业链）分析
 - 5.1.1 中国半导体硅片产业链结构梳理
 - 5.1.2 中国半导体硅片产业链生态图谱
 - 5.2 中国半导体硅片产业价值属性（价值链）分析
 - 5.2.1 中国半导体硅片行业成本结构分析
 - 5.2.2 中国半导体硅片行业价值链分析
 - 5.3 中国半导体硅片产业链发展痛点分析
 - 5.4 中国半导体硅片产业链“专精特新”鼓励布局方向
- 第6章：中国半导体硅片产业链环节“专精特新”布局状况研究
 - 6.1 中国半导体硅片产业生产设备市场“专精特新”布局状况研究
 - 6.1.1 中国半导体硅片产业生产设备市场发展现状
 - (1) 生产设备-晶体生长炉市场发展现状
 - (2) 生产设备-单晶硅截断机市场发展现状
 - (3) 生产设备-单晶棒滚磨机市场发展现状
 - 6.1.2 中国半导体硅片产业生产设备市场发展痛点分析
 - 6.1.3 中国半导体硅片产业生产设备市场“专精特新”市场培育现状
 - 6.1.4 中国半导体硅片产业生产设备市场竞争格局分析
 - 6.1.5 中国半导体硅片产业生产设备市场发展前景及趋势
 - 6.2 中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片“专精特新”布局状况研究
 - 6.2.1 中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片发展现状分析
 - (1) 8寸（200mm）及以下单晶硅片市场发展规模
 - (2) 8寸（200mm）及以下单晶硅片技术发展现状
 - (3) 8寸（200mm）及以下单晶硅片国产化发展现状
 - 6.2.2 中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片发展痛点分析
 - 6.2.3 中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片“专精特新”市

场培育现状

析

现状

现状

6.2.4 中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片市场竞争格局分

6.2.5 中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片发展前景及趋势

6.3 中国半导体硅片行业细分市场-12寸（300MM）单晶硅片“专精特新”布局状况研究

6.3.1 中国半导体硅片行业细分市场-12寸（300MM）单晶硅片发展现状分析

（1）12寸（300MM）单晶硅片市场发展规模

（2）12寸（300MM）单晶硅片技术发展现状

（3）12寸（300MM）单晶硅片国产化发展现状

6.3.2 中国半导体硅片行业细分市场-12寸（300MM）单晶硅片发展痛点分析

6.3.3 中国半导体硅片行业细分市场-12寸（300MM）单晶硅片“专精特新”市场培育

6.3.4 中国半导体硅片行业细分市场-12寸（300MM）单晶硅片市场竞争格局分析

6.3.5 中国半导体硅片行业细分市场-12寸（300MM）单晶硅片发展前景及趋势

6.4 中国半导体硅片行业细分市场-18寸（450mm）单晶硅片“专精特新”布局状况研究

6.4.1 中国半导体硅片行业细分市场-18寸（450mm）单晶硅片发展现状分析

（1）18寸（450mm）单晶硅片市场发展规模

（2）18寸（450mm）单晶硅片技术发展现状

（3）18寸（450mm）单晶硅片国产化发展现状

6.4.2 中国半导体硅片行业细分市场-18寸（450mm）单晶硅片发展痛点分析

6.4.3 中国半导体硅片行业细分市场-18寸（450mm）单晶硅片“专精特新”市场培育

6.4.4 中国半导体硅片行业细分市场-18寸（450mm）单晶硅片市场竞争格局分析

6.4.5 中国半导体硅片行业细分市场-18寸（450mm）单晶硅片发展前景及趋势

第7章：中国半导体硅片行业区域发展格局及“专精特新”发展研究

7.1 中国半导体硅片产业资源区域分布状况

7.2 中国半导体硅片行业企业数量区域分布

7.3 中国半导体硅片行业区域发展格局分析

7.4 中国各省市半导体硅片行业“专精特新”政策环境分析

7.5 中国各省市半导体硅片行业“专精特新”企业培育方案及申报条件

7.5.1 半导体硅片行业省市级“专精特新”企业培育方案解读

（1）省级“专精特新”企业培育方案解读

（2）市级“专精特新”企业培育方案解读

7.5.2 半导体硅片行业省市级“专精特新”企业奖励标准

7.5.3 半导体硅片行业省市级“专精特新”企业申报条件解读

（1）省级“专精特新”企业申报条件

（2）市级“专精特新”企业申报条件

7.5.4 半导体硅片行业省市级“专精特新”企业申报流程解读

（1）省级“专精特新”企业申报流程

（2）市级“专精特新”企业申报流程

7.6 中国各省市半导体硅片行业“专精特新”市场培育现状

第8章：中国半导体硅片行业代表性企业“专精特新”布局对比及案例研究

8.1 中国半导体硅片行业代表性企业“专精特新”布局对比

8.2 中国半导体硅片行业代表性“小巨人”企业布局案例研究

8.2.1 企业一

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业发展状况

（3）企业半导体硅片业务类型及产品介绍

（4）企业半导体硅片产业链布局状况

（5）企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向

（6）企业半导体硅片业务布局优劣势分析

8.2.2 企业二

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业发展状况

（3）企业半导体硅片业务类型及产品介绍

（4）企业半导体硅片产业链布局状况

（5）企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向

（6）企业半导体硅片业务布局优劣势分析

8.2.3 企业三

- (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业发展状况
 - (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍
 - (4) 企业半导体硅片产业链布局状况
 - (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向
 - (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析
- 8.2.4 企业四
- (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业发展状况
 - (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍
 - (4) 企业半导体硅片产业链布局状况
 - (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向
 - (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析
- 8.2.5 企业五
- (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业发展状况
 - (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍
 - (4) 企业半导体硅片产业链布局状况
 - (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向
 - (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析
- 8.2.6 企业六
- (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业发展状况
 - (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍
 - (4) 企业半导体硅片产业链布局状况
 - (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向
 - (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析
- 8.2.7 企业七
- (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业发展状况
 - (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍
 - (4) 企业半导体硅片产业链布局状况
 - (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向
 - (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析
- 8.2.8 企业八
- (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业发展状况
 - (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍
 - (4) 企业半导体硅片产业链布局状况
 - (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向
 - (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析
- 8.2.9 企业九
- (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业发展状况
 - (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍
 - (4) 企业半导体硅片产业链布局状况
 - (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向
 - (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析
- 8.2.10 企业十
- (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业发展状况
 - (3) 企业半导体硅片业务类型及产品介绍
 - (4) 企业半导体硅片产业链布局状况
 - (5) 企业半导体硅片业务“专精特新”布局动向
 - (6) 企业半导体硅片业务布局优劣势分析

第9章：中国半导体硅片行业“专精特新”发展趋势预判及前景预测

9.1 中国半导体硅片行业市场前景预测

9.2 中国半导体硅片行业“专精特新”发展趋势预判

9.3 中国半导体硅片行业“专精特新”发展前景预测

- 第10章：中国半导体硅片行业“专精特新”投资特性及投资机会分析
 - 10.1 中国半导体硅片行业“专精特新”投资特性分析
 - 10.1.1 中国半导体硅片行业“专精特新”投资壁垒分析
 - 10.1.2 中国半导体硅片行业“专精特新”投资风险预警及防范
 - 10.2 中国半导体硅片行业“专精特新”投资价值评估
 - 10.3 中国半导体硅片行业“专精特新”投资机会分析
 - 10.3.1 产业链薄弱环节投资机会
 - 10.3.2 区域市场投资机会
 - 10.3.3 细分市场投资机会
 - 10.4 中国集成电路设计行业“专精特新”潜在发展方向分析
- 第11章：中国半导体硅片行业“专精特新”投资策略及发展建议
 - 11.1 中国半导体硅片行业“专精特新”投资策略
 - 11.2 中国半导体硅片行业“专精特新”发展建议

图表目录

- 图表1：中国半导体硅片行业本土企业布局情况
- 图表2：中国半导体硅片行业发展机遇与挑战分析
- 图表3：截至2024年中国半导体硅片行业发展政策汇总-国家层面
- 图表4：截至2024年中国半导体硅片行业发展规划汇总-国家层面
- 图表5：截至2024年中国半导体硅片行业“专精特新”发展政策解读-国家层面
- 图表6：中国半导体硅片产业链发展痛点分析
- 图表7：中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片本土企行业布局情况
- 图表8：中国半导体硅片行业细分市场-8寸（200mm）及以下单晶硅片发展痛点分析
- 图表9：中国半导体硅片行业细分市场-12寸（300MM）单晶硅片本土企行业布局情况
- 图表10：中国半导体硅片行业细分市场-12寸（300MM）单晶硅片发展痛点分析
- 图表11：中国半导体硅片行业细分市场-18寸（450mm）单晶硅片本土企行业布局情况
- 图表12：中国半导体硅片行业细分市场-18寸（450mm）单晶硅片发展痛点分析
- 图表13：企业一发展历程
- 图表14：企业一基本信息表
- 图表15：企业一股权穿透图
- 图表16：企业一经营状况
- 图表17：企业一整体业务架构
- 图表18：企业一销售网络布局
- 图表19：企业一半导体硅片业务布局优劣势分析
- 图表20：企业二发展历程
- 图表21：企业二基本信息表
- 图表22：企业二股权穿透图
- 图表23：企业二经营状况
- 图表24：企业二整体业务架构
- 图表25：企业二销售网络布局
- 图表26：企业二半导体硅片业务布局优劣势分析
- 图表27：企业三发展历程
- 图表28：企业三基本信息表
- 图表29：企业三股权穿透图
- 图表30：企业三经营状况
- 图表31：企业三整体业务架构
- 图表32：企业三销售网络布局
- 图表33：企业三半导体硅片业务布局优劣势分析
- 图表34：企业四发展历程
- 图表35：企业四基本信息表
- 图表36：企业四股权穿透图
- 图表37：企业四经营状况
- 图表38：企业四整体业务架构
- 图表39：企业四销售网络布局
- 图表40：企业四半导体硅片业务布局优劣势分析

图表41: 企业五发展历程
图表42: 企业五基本信息表
图表43: 企业五股权穿透图
图表44: 企业五经营状况
图表45: 企业五整体业务架构
图表46: 企业五销售网络布局
图表47: 企业五半导体硅片业务布局优劣势分析
图表48: 企业六发展历程
图表49: 企业六基本信息表
图表50: 企业六股权穿透图
图表51: 企业六经营状况
图表52: 企业六整体业务架构
图表53: 企业六销售网络布局
图表54: 企业六半导体硅片业务布局优劣势分析
图表55: 企业七发展历程
图表56: 企业七基本信息表
图表57: 企业七股权穿透图
图表58: 企业七经营状况
图表59: 企业七整体业务架构
图表60: 企业七销售网络布局
图表61: 企业七半导体硅片业务布局优劣势分析
图表62: 企业八发展历程
图表63: 企业八基本信息表
图表64: 企业八股权穿透图
图表65: 企业八经营状况
图表66: 企业八整体业务架构
图表67: 企业八销售网络布局
图表68: 企业八半导体硅片业务布局优劣势分析
图表69: 企业九发展历程
图表70: 企业九基本信息表
图表71: 企业九股权穿透图
图表72: 企业九经营状况
图表73: 企业九整体业务架构
图表74: 企业九销售网络布局
图表75: 企业九半导体硅片业务布局优劣势分析
图表76: 企业十发展历程
图表77: 企业十基本信息表
图表78: 企业十股权穿透图
图表79: 企业十经营状况
图表80: 企业十整体业务架构
图表81: 企业十销售网络布局
图表82: 企业十半导体硅片业务布局优劣势分析
图表83: 中国半导体硅片行业“专精特新”领域投资价值评估
如需完整目录请联系客服

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：<https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务！